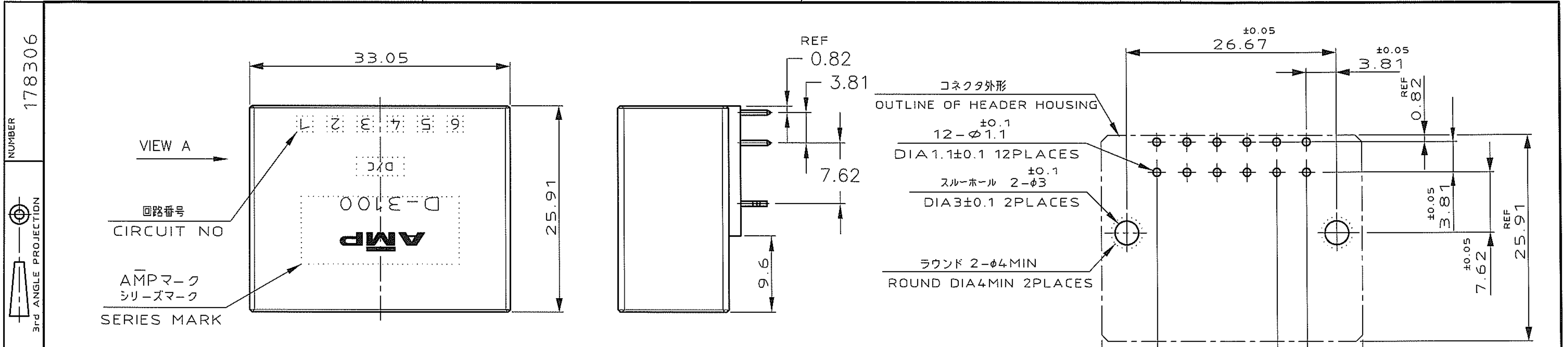

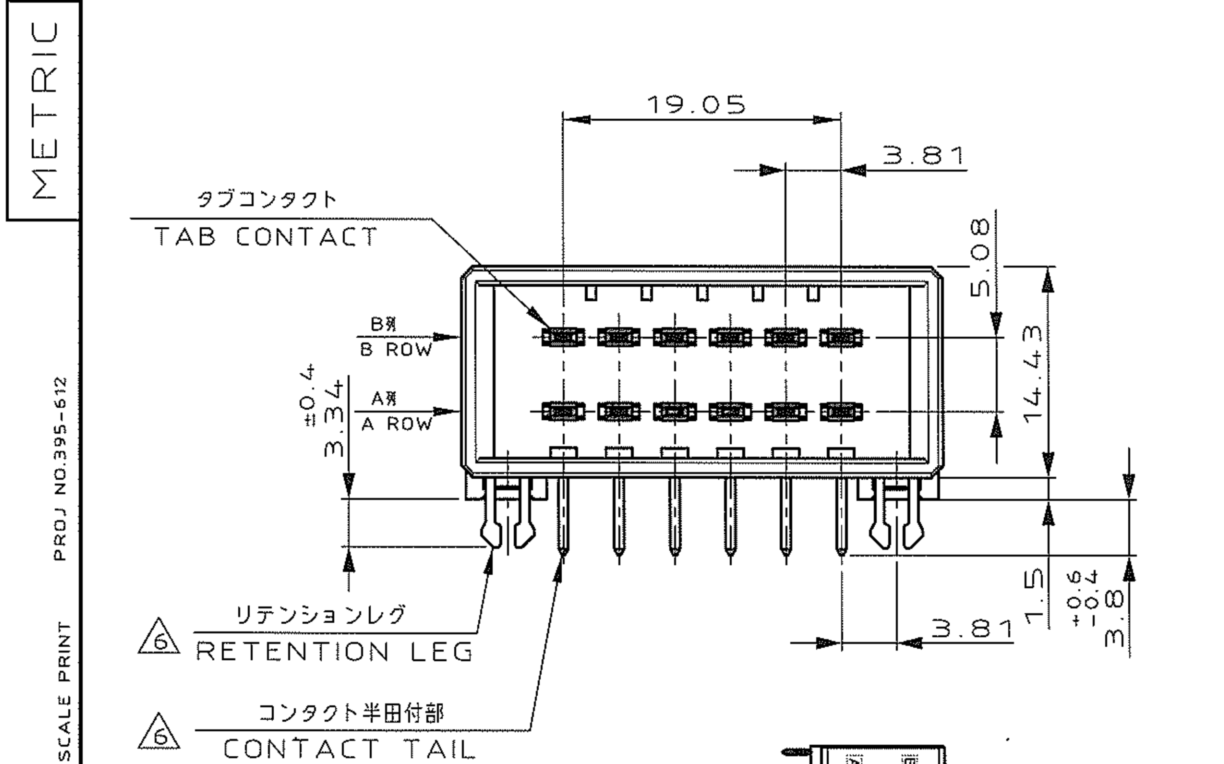

推奨基板取付け穴寸法

PC 基板厚：1.6±0.1
（非累積公差）
（コネクタ搭載面）

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN

PC BOARD THICKNESS:1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

1. MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC,POLYESTER
CONTACT:COPPER ALLOY
RETENTION LEG:COPPER ALLOY

2. FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING

3. FINISH(CONTACT AREA):0.76μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING

4. FINISH(CONTACT AREA):2.0 μmMIN TIN PLATED OVER NICKEL

~~5. FINISH(RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL~~

6. FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注 記

1. 材料：ハウジング：ガラス入り熱可塑性 ポリエステル樹脂
コンタクト：銅合金
リテンションレグ：銅合金

2. めっき：コンタクト：全面Ni下地 接触部：0.38μm MIN金めっき

3. めっき：コンタクト：全面Ni下地 接触部：0.76μm MIN金めっき

4. めっき：コンタクト：全面Ni下地 接触部：2.0 μm MINスズめっき

~~5. めっき：リテンションレグとコンタクト半田付部 ：ニッケル下地の上に半田めっき~~

6. めっき：リテンションレグとコンタクト半田付部 ：ニッケル下地の上にスズめっき

VIEW A
(SCALE:1:1)

(FINISH)		製品番号 (PART NO.)
6	4	178306-5
6	3	178306-3
6	2	178306-2

LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
B1	REVISED ECR-07-013273	TS	DM	11JUN 2007
B	REVISED(FJD0-0039-03)	TS	S.M	6/2 '03
A	REVISED(FJD0-0114-03)	TS	SM	25.APR '03
0	RELEASED FJ00-2528-95	NM	Y.I	6/30 '95

Copyright © 1995
AMP(Japan) LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.

Tyco Electronics
Tyco Electoronics AMP K.K
Kawasaki,Japan

NAME: 12 POS DOUBLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100

WIRE RANGE	INSULATION DIA
~~mm²(AWG -)~~	~~- mm⌀~~
MATERIAL: SEE NOTE 注記参照	FINISH: SEE NOTE 注記参照
DR. 23 JUN 95 N.Matsubara	DE. 23 JUN 95 N.Matsubara
CHK. 30 JUN 95 Y.ISHIKAWA	APP. 3 JUL 95 S.MANABE

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
10以下 ±0.3
10を越え30以下 ±0.4
30を越え100以下 ±0.45
角度 ±3°

SIZE	LOC	NUMBER
A3	J	C-178306

SCALE	REV.	SHEET
2-1	B1	1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面

NUMBER 178306
3rd ANGLE PROJECTION
METRIC
PROJ NO.395-612
DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT
PRINT DIST
AMP-J REV.10/'83